

证券代码：002916

证券简称：深南电路

深南电路股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-65

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（ <u>券商策略会</u> ）
活动参与人员（排名不分先后）	花旗、贝莱德资产管理、Point72、APG Investments Europe、APG Investments Europe、Bosera Asset Management Co Ltd、Brilliance Asset Management Limited、First State Stewart Asia、Pictet AM、Sumitomo Mitsui Trust AM、Templeton Emerging Markets GRP、UBS AM London
上市公司接待人员	证券事务主管：阳佩琴；投资者关系经理：郭家旭
时间	2024年11月5日
地点	花旗策略会举办地
形式	实地调研
投资者关系活动主要内容介绍	<p>交流主要内容：</p> <p>Q1、请介绍公司主营业务基本情况。</p> <p>公司专注于电子互联领域，拥有印制电路板、电子装联、封装基板三项主营业务，形成了业界独特的“3-In-One”业务布局，印制电路板与封装基板业务“技术同根”，电子装联与印制电路板业务“客户同源”，三项业务在各自领域相继拓展的同时，高效协同共筑起公司电子电路互联技术能力平台。公司具备提供“样品→中小批量→大批量”的综合制造能力，通过开展方案设计、制造、电子装联、微组装和测试等全价值链服务，能够为客户提供专业高效的一站式综合解决方案。业务产品下游应用广泛，拥有较为深厚的行业积淀和扎实的客户基础。</p> <p>Q2、请介绍公司2024年第三季度营业收入及综合毛利率环比变化情况。</p> <p>2024年第三季度，公司营业收入47.28亿元，环比增长8.45%，主要由于电子装联业务项目结算增加影响，营收规模环比增加。公司综合毛利率环比略有下降，一方面由于电子装</p>

联业务规模增长（因业务形态特点，其毛利率一般略低于公司综合毛利率）；同时封装基板及 PCB 业务受产品结构变化影响，业务毛利率环比下降。此外，广州封装基板新工厂产能爬坡、原材料涨价对第三季度综合毛利率也造成一定负向影响。

Q3、请介绍公司 2024 年第三季度 PCB 业务各下游领域经营拓展情况。

公司 PCB 业务产品下游应用以通信设备为核心，重点布局数据中心（含服务器）、汽车电子等领域，并长期深耕工控、医疗等领域。2024 年第三季度，受通用服务器需求及国内汽车电子产品需求增长影响，公司 PCB 业务营收在数据中心及汽车电子领域环比二季度有所提升，通信领域受无线侧通信基站相关产品需求无明显改善影响，营收占比有所下降。

Q4、请介绍公司 PCB 业务有无进一步扩产的空间。

公司 PCB 业务在深圳、无锡、南通及未来泰国项目均设有工厂。一方面，公司可通过对现有成熟 PCB 工厂进行持续的技术改造和升级，增进生产效率，释放一定产能；另一方面，公司在南通基地尚有土地储备，具备新厂房建设条件，南通四期项目已有序推进基建工程，拟建设为具备覆盖 HDI 等能力的 PCB 工艺技术平台。公司将结合自身经营规划与市场需求情况，合理配置业务产能。

Q5、请介绍公司泰国项目规划及当前建设进展。

公司为进一步拓展海外市场，满足国际客户需求，在泰国投资建设工厂，总投资额为 12.74 亿元人民币/等值外币。目前基础工程建设有序推进中，具体投产时间将根据后续建设进度、市场情况等因素确定。

Q6、请介绍公司 2024 年第三季度封装基板业务经营拓展情况。

公司封装基板业务产品覆盖种类广泛多样，包括模组类封装基板、存储类封装基板、应用处理器芯片封装基板等，主要应用于移动智能终端、服务器/存储等领域。2024 年第三季度，封装基板下游市场需求有所放缓，公司封装基板产品结构随下游市场需求波动有所调整。

Q7、请介绍公司 2024 年第三季度 PCB 及封装基板工厂稼动率较第二季度变化情况。

公司 2024 年第三季度 PCB 工厂稼动率环比基本持平，维持在高位水平；封装基板工

	<p>厂稼动率随下游部分领域需求波动略有回落。</p> <p>Q8、请介绍无锡基板二期工厂、广州封装基板项目连线爬坡进展。</p> <p>公司无锡基板二期工厂于 2022 年 9 月下旬连线投产，目前已实现单月盈亏平衡。广州封装基板项目一期已于 2023 年第四季度连线，产品线能力在今年上半年快速提升，目前其产能爬坡尚处于前期阶段，重点仍聚焦平台能力建设，推进客户各阶产品认证工作。</p> <p>Q9、请介绍公司封装基板业务在 FC-BGA 技术能力方面取得的进展。</p> <p>公司 FC-BGA 封装基板已具备 16 层及以下产品批量生产能力，16 层以上产品具备样品制造能力，其中 20 层产品送样认证工作有序推进中。公司后续将进一步加快高阶领域产品技术能力突破和市场开发，同时也将继续引入该领域的技术专家人才，加强研发团队培养，提升巩固核心竞争力。</p> <p>Q10、请介绍公司对电子装联业务的定位及布局策略。</p> <p>公司电子装联业务属于 PCB 制造业务的下游环节，按照产品形态可分为 PCBA 板级、功能性模块、整机产品/系统总装等，业务主要聚焦通信及数据中心、医疗、汽车电子等领域。公司发展电子装联业务旨在以互联为核心，协同 PCB 业务，发挥公司电子互联产品技术平台优势，通过一站式解决方案平台，为客户提供持续增值服务，增强客户粘性。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>调研过程中公司严格遵照《信息披露管理制度》等规定，未出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
<p>附件清单</p>	<p>无</p>